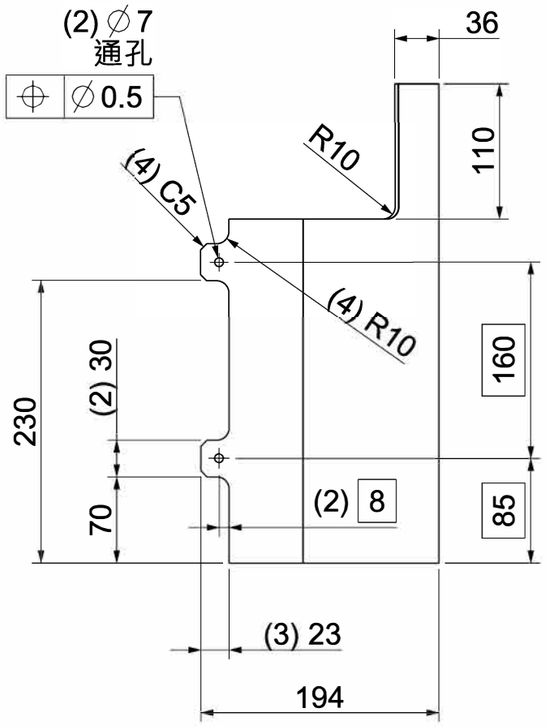
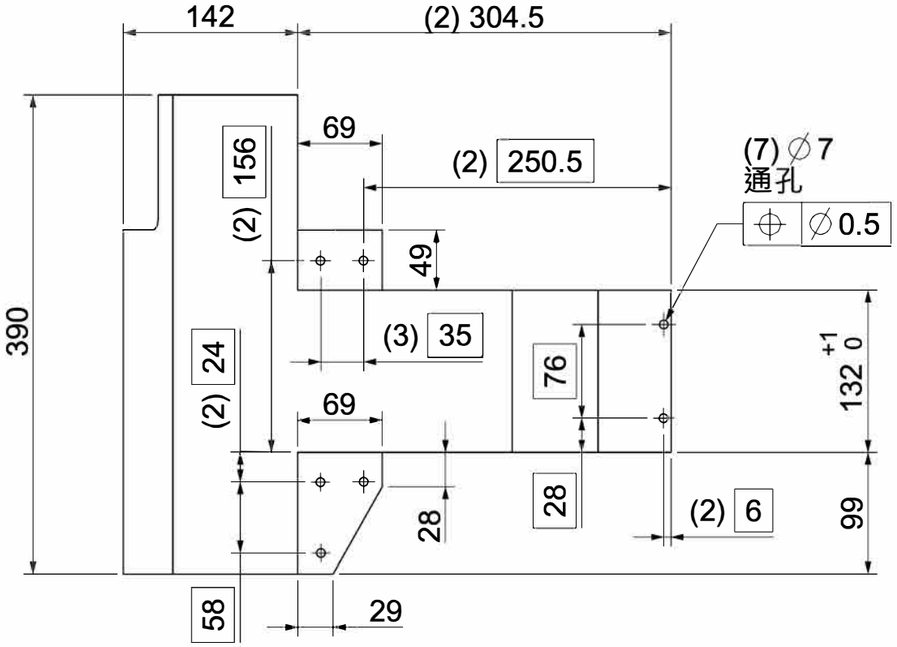
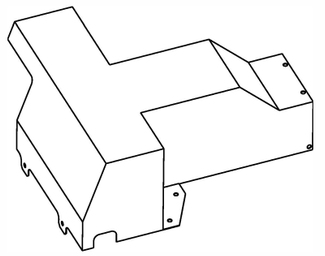
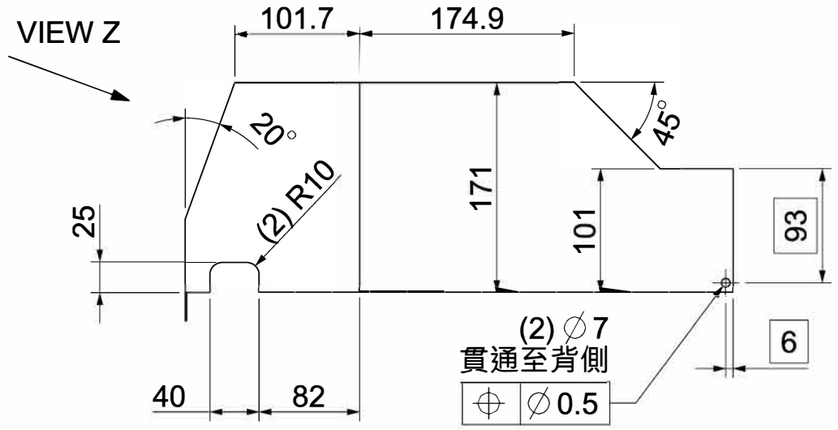
管制編號:

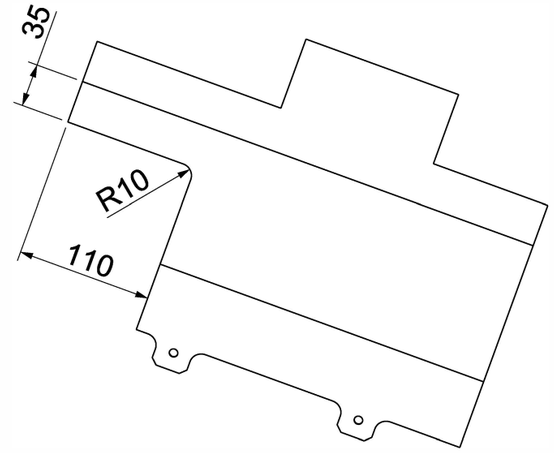






比例 1:10





VIEW Z

備註:
1. 材料: SGCC, 鈑厚1mm
2. 未標註之尺寸參考3D: SL-26MK1-A008-10.STP
3. 未標註之公差參考一般鈑金折彎、尺寸與焊接公差
4. 採鈑金雷割+焊接工法成型
5. 去除所有銳角、毛邊與焊渣
6. 表面處理: 全件噴漆, 亞光橄欖綠

	SL-26MK1-A008-10	SL-26MK1-A008-10	-	SGCC	2.247	
件數	3D檔名	件號	圖紙號	材料與尺寸規格	重量(kg)	
加工一般公差	繪圖	20261022	李芳明	工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute		
>0 ±0.1 >6 ±0.2 >30 ±0.3 >120 ±0.5 >315 ±0.8 >1000 ±1.2	設計	20261022	李芳明			
	審校		曹 嘉			
	核准		曹 嘉			
		日期	姓名			
孔與孔中心距公差 ±0.3	計畫代號	-		圖名: 基座遮蓋	圖框: A3	
鑽孔、沉頭孔公差 +0.25 -0.05	工令代號					
角度 ±1/2°	分總圖圖號			件名(EN): COVER BASE	版次	
	總圖圖號			比例 1:5	圖紙號 -	1.0

Sign	次序	更改區域	原始	更改	日期	負責人

ED3.0/2023.12